

PowerWize BMI（盲插配接口）

高电流面板到板/母排互连

PowerWize BMI 连接器采用 Molex 的 COEUR 插座技术，通过直角和垂直型插座头实现高载流能力。有三种尺寸可供选择：3.40 毫米 (75.0A)、6.00 毫米 (110.0A) 和 8.00 毫米 (185.0A)，且盲插配设计有助于确保在难以触及和有视觉遮挡的空间进行正确连接。



盲插配
直角插座头



盲插配
垂直插座头



盲插配
面板安装插座压接



压接触点

优势和特性

支持在需要时将垂直插座头与面板安装插座插配
垂直插座头可用于 8.00 毫米连接器。

允许面板安装插座具有 ±2.00 毫米径向浮动量，以消除公差累积问题
自对准面板安装插座法兰可兼容两种装配方案：与螺栓配对的压入式支座（适用于装配人员可单侧操作场景），或与螺母配对的带肩螺丝（适用于装配人员可双侧操作场景）。

有助于确保直角插座头在印刷电路板或母排上的方向正确
插座头配备机械键控结构，带挤压/定位销。

提供防端子脱落保障
两个（相对的）正向锁扣将 TPA 固定器稳固锁附于盲插配插座外壳筒仓内，同时六个接触梁在 TPA 固定器内部牢固夹持压接触点。

电流	175.0A
电压	1000V
耐久度（最小值）	200 次插拔
工作温度	-40°C 至 +125°C

有助于确保触点接口处实现低接触电阻、低电压降和最小的发热量
PowerWize 互连产品具有多个接触梁，可实现最佳电流承载能力。

有助于确保插座安装方向正确
采用机械键控设计，面板安装插座前端与匹配的面板切口均设有独特几何结构。

提供将插针连接到不同基板的选项，以实现设计和制造的灵活性
螺钉安装引脚与印刷电路板和母排同时连接；焊尾插针与印刷电路板连接。

抽屉式应用中，当连接器被遮挡时，可使插座头护套内壁在插配过程中对齐连接器盲插配导柱促进无故障插配。

有助于防止插座和插座头之间的错配
该系列连接器采用机械键控设计，面板安装插座前端与匹配的插座头护套均设有独特几何结构。

提供设计和制造灵活性
可提供压接触点以适应各种线规（10 AWG 至 1/0 AWG）。

PowerWize BMI (盲插配接口) 高电流面板到板/母排互连

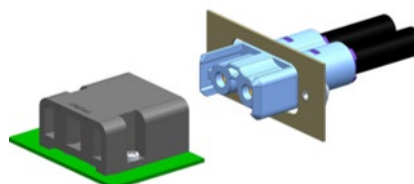
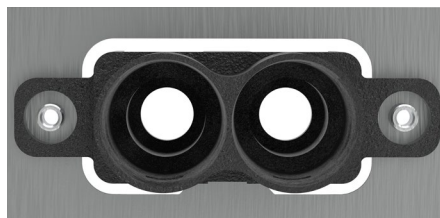
优势和特性

实现额外的板固定 (如果需要)

次级基板贴装方式包括: 通过 M3 螺栓、螺母, 以及接插座头本体成型的两处安装法兰, 将直角接插座头固定于基板。

有助于确保电线和压接筒之间的接口处的接触电阻最小

可靠的八边形压接几何结构设计, 相较于其他方案可显著降低系统发热量并提升载流能力。



市场和应用

电信/网络

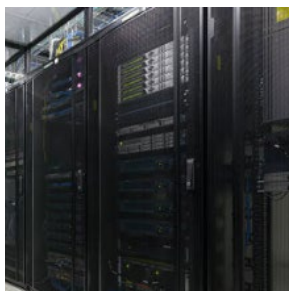
服务器
数据存储单元
配电单元 (PDU)
不间断电源
数字交叉连接交换机
网络路由器

数据中心

数据中心的电力
服务器
数据存储单元
电源架
配电单元 (PDU)
不间断电源
环境控制设备

充电基础设施

电动车 (EV) 充电站



不间断电源



数据中心服务器



电动汽车充电站

PowerWize BMI（盲插配接口） 高电流面板到板/母排互连

规格

参考信息

包装：插座头和 TPA 固定器：托盘
面板安装插座外壳：袋装
压接触点：真空包装袋
请参阅包装规格以获取更多详细信息
可搭配使用的产品：印刷电路板和母排
设计单位：毫米
RoHS：是

物理

面板安装插座外壳：PBT（黑色）
TPA 固定器：PBT（黑色）
插座头外壳：LCP（黑色）
触点：高性能铜合金
电镀：
插座接触区域：金
插座头引脚：银
PCB 厚度（最小值）：1.60 毫米
母排厚度（最小值）：1.50 毫米
工作温度：-40°C 至 +125°C

3.40 毫米尺寸 电气

电压（最大值）：400.0V
电流（最大值）：75.0A
接触电阻（最大值）：0.25 毫欧
工作温度：-40°C 至 +125°C

机械

全连接器插配力（最大值）：45.0N
全连接器拔出力（最小值）：10.0N
耐用度（最小值）：200 次插拔

6.00 毫米尺寸 电气

电压（最大值）：600.0V
电流（最大值）：110.0A
接触电阻（最大值）：0.1 毫欧

机械

全连接器插配力（最大值）：60.0N
全连接器拔出力（最小值）：12.0N
耐用度（最小值）：200 次插拔

8.00 毫米尺寸 电气

电压（最大值）：1,000.0V
电流（最大值）：185.0A
接触电阻（最大值）：0.1 毫欧

机械

全连接器插配力（最大值）：70.0N
全连接器拔出力（最小值）：20.0N
耐用度（最小值）：200 次插拔